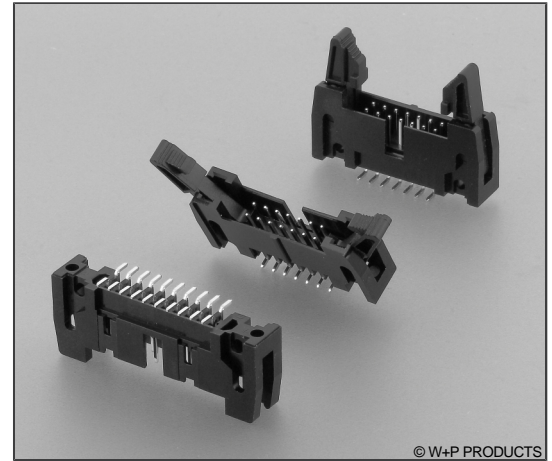


SMT-Wannenstiftleisten mit Verriegelung RM 2,54mm, stehend SMT Box Headers with Latches, 2.54mm Pitch, Vertical

Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Kontaktfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options, over Ni</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500 V AC |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 250 V AC |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 3 A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40 °C ... +105 °C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i> |

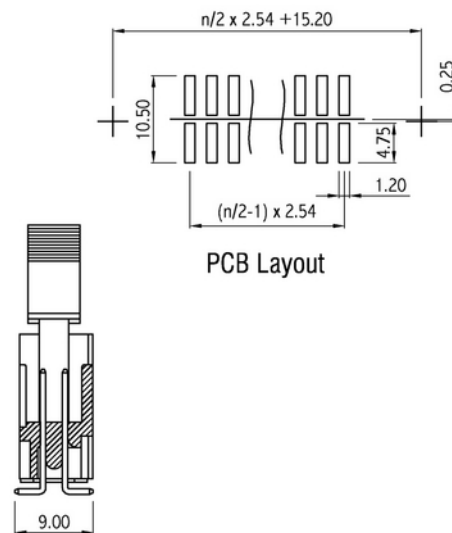
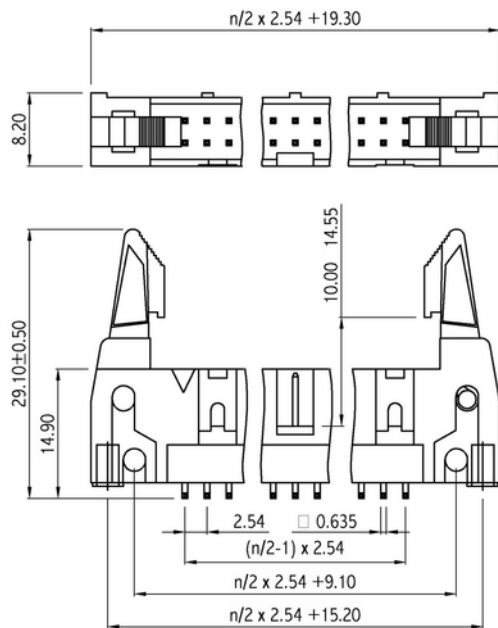


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Compatible Connector Series:

141

Lange Hebel für Gegenstecker mit Zugentlastung
Long Latches for Mating Connectors with Strain Relief



PCB Layout

| Series | Contacts* | Latches* | Plating* | Package |
|-------------|---|--|---|--|
| 1380 | 10 10 14 16 20 26 34 40 50 | 10 00 Ohne Hebel W/o latches 10 Kurze Hebel Short latches 20 Lange Hebel Long latches | 00 00 Vergoldet Gold plated 60 Sel. Au/Sn Duplex Plating | ST ST In Stangen In tubes |

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

